

捷敏股份有限公司

提升企業價值計畫

[現況分析]

一. 成本分析

(一) 財務結構與資本運作：

本公司目前的實收資本額為129,047仟元，歷年來採取以自有資金為主並謹慎運用債務的經營策略。

1. 穩健的資本結構

本公司資本結構係由69%權益和31%債務組成，低負債經營的模式，可降低高負債帶來的財務風險。同時公司保持充足的現金流，未來若需要擴張，公司仍有穩定的資金可供運用。

2. 低財務成本運作

不只是追求便宜的資金來源，更是避免過度槓桿，確保公司在景氣波動時仍能承受。

3. 持續監控與優化

本公司定期檢視權益與債務的比例是否仍符合公司策略，並關注外部市場環境，如利率政策、資本市場狀況，及時調整資金配置與融資策略，確保在市場不確定性下能獲得低成本融資支援。

二. 獲利能力評估

(一) ROIC和ROE評估：

公司的經營效能可透過投入資本報酬率(ROIC)和權益報酬率(ROE)進行評估。具體而言，本公司2025年，ROIC達到22%，表示有良好的資金使用效率，另，ROE達到16%，表示公司有效地運用股東權益獲得良好的報酬。本公司的ROIC 和ROE表現，顯示管理階層的有效資本配置。

(二) 業務分析：

本公司營收年複合成長率約 6.7%，顯示功率半導體需求穩健。隨著電動車與工業控制需求增加、5G、車用電子、白色家電等應用推動功率半導體需求，有望為未來營收成長的驅動力。

三. 市場評價分析

(一) 評價水準分析：

本公司截至2025年12月底股價淨值比(PBR): 2.07倍，主係因本公司長期採取低槓桿經營策略，且穩健的獲利與現金流使公司具長期投資價值。本公司將持續高附加價值，以及第三代半導體相關產品之開發等擴大營運規模。我們將致力於確保投資人對我們的評價能反映出公司真實的內涵價值。

(二) 潛在成長評估：

公司審慎樂觀看待公司提供之半導體封測服務在市場上的需求，因電子零組件在體積及性能上不斷改善提升，且產品壽命越來越短等等因素，為公司提供了正向的市場機會。目前股價表現與此潛在成長動能相符，因此無需調整業務戰

略。

四. 公司治理分析

(一) 董事會結構及獨立性：

本屆董事會於2024年5月完成改選，初始由5席一般董事及4席獨立董事組成；嗣後1席獨立董事於2025年7月辭任，現行董事會由8席董事構成。在組成結構上，本公司董事會兼顧股權基礎穩定性與專業背景多元性，董事成員歷練橫跨多項專業領域，且獨立董事與女性董事席次比例均達三分之一，符合公司現階段營運發展與治理需求。本公司透過董事會結構之多元化及獨立性，促使董事會決策過程充分考慮各種專業知識和觀點，並能獨立於公司管理階層，提供客觀的意見和建議。

(二) 董事會運作之有效性：

本公司每年對董事會和功能性委員會進行績效評估，以提升其運作之有效性，評估內容包括對公司營運之參與程度、決策品質、成員之結構與選任、持續進修、內部控制等，以健全公司治理結構。

(三) 資訊透明度：

本公司董事會每季至少開會一次，除每季於審議財務報告前，需於開會召集通知日同步發布重訊公告開會日期外，其他依法應揭露之重要決議事項，會後亦即時公開揭露。此外，資訊透明度政策包括對重大決議事項的揭露和說明，以確保股東充分了解公司的營運和策略方向。

本公司設有與股東/投資人溝通管道：

1. 中(英)文網站，網址：<https://www.gemservices.com>，於「投資人專區」中揭露相關財務業務及公司治理資訊。【永久設置】
2. 股東會【一年一次】
3. 法說會【一年一次】
4. 投資人電詢事項回覆【不定期】
5. 年報 / 永續報告書【定期】
6. 發言人暨代理發言人信箱【永久設置】
7. 公開資訊觀測站資訊揭露與申報【永久設置】

五. 風險及競爭評估

(一) 總體經濟分析：

本公司係註冊於開曼群島，主要營運地為薩摩亞、英屬維京群島、中國大陸及中華民國等地，故註冊地與主要營運地之總體經濟、政治環境之變動與外匯之波動，皆會影響本公司及本公司之子公司之營運狀況。

另，電子產品的需求隨著消費市場、貿易環境以及各國政府政策而變化。近年來電子零組件在體積及性能上不斷改善提升，產品壽命越來越短，供應鏈競爭越來越激烈，而相關法規對產品及工廠的要求也越來越多，本公司對外擴大產品應用，開發潛力客戶，拓展產品系列並管控投資風險、持續關注因地緣政治因素所造成供應鏈之變化並採取相對應之措施。對內依據產業環境，營運狀況，透過持續經營檢討及內控機制，鑑別可能風險並擬定相關因應措施，以降低營運風險。

(二) 產業競爭分析：

本公司專業於功率半導體之封測服務，本公司之客戶群不僅限於IDM，同時包括IC設計公司，且應用產品擴及消費性電子、工業產品、家電等領域，不因某單一產業或單一類型客戶之營運變化而對公司營運造成重大波動。

[政策與計畫]

一. 短期強化計畫

短期而言，為提升資本使用效率，本公司除將進一步深化與現有客戶的夥伴合作，同時開發新客戶。透過提升營運效能、提高產能利用率，以及謀求合理的獲利水準，以期實現短期內的業務發展目標。同時，本公司將持續改善董事會的多元性和獨立性，透過定期評估董事會成員的表現和公司治理實踐情形，以增強董事會對管理層的監督能力。

二. 中長期強化計畫

展望未來，本公司將持續高附加價值，以及第三代半導體相關產品之開發等。其策略規劃如下：(1) 結合客戶的應用需求，開拓產品線之廣度及深度；(2) 持續開發關鍵技術及需要製程，並因應產業趨勢發展新世代產品，保持分離式元件產業領先地位；(3) 積極與客戶共同開發，強化服務。尋求與客戶建立策略合作關係；(4) 不斷藉由產品升級，使產品定位提升至一般甚至模組化功率半導體封裝測試市場領導地位；(5) 推動綠色研發和技術創新，增加在綠色技術和永續發展的研發投資，並在產品設計和製造過程中融入環保標準，符合全球節能減排趨勢。本公司將積極善盡企業責任，強化公司治理，提升各項產品核心技術競爭力，打造永續供應鏈，深化客戶互信與夥伴關係，攜手成長，進而持續提升股東價值。

本公司透過穩健財務結構、持續成長的獲利能力、良好的市場評價、健全公司治理，搭配短期效率提升與中長期技術創新策略，將持續提升股東價值。